mercado, circuitos integrados (CIs) de arseneto de gálio, GaAs, ocupam lugar de destaque principalmente em aplicações como optoeletrônica e circuitos de alta frequência. No processo de fabricação de CIs de GaAs, um importante passo é a isolação elétrica entre dispositivos adjacentes, a qual pode ser alcançada por meio de diferentes técnicas. Dentre estas, a isolação por implantação iônica tem ganhado cada vez mais destaque. Trata-se de uma técnica que utiliza um equipamento padrão da indústria de semicondutores, o implantador iônico. Ele pode ser usado para introduzir defeitos cristalinos na rede do GaAs. Estes defeitos atuam como armadilhas para os portadores livres, aumentando drasticamente a resistividade das regiões

A indústria de semicondutores é um dos setores mais importantes na economia global atualmente. Dentro deste gigantesco

implantadas. O estudo, identificação e caracterização desses defeitos são passos de caráter crucial para o aperfeicoamento e otimização da etapa de isolação por implantação. No presente trabalho, foi utilizada a técnica de Espectroscopia de Transientes de Níveis Profundos (DLTS - Deep Level Transient Spectroscopy) para identificar e caracterizar níveis com energias próximas à da banda de valência do GaAs. Esta região da banda proibida ainda não havia sido analisada em trabalhos anteriores. Dois níveis que estão relacionados a defeitos introduzidos pela implantação de prótons foram identificados: um com energia aparente de $E_v + 0.08$ eV e secção de choque de captura de lacunas de $4x10^{-15}$ cm²; e outro com energia de $E_v +$ 0.1 eV e secção de choque de 2.5x10⁻¹⁵ cm². A evolução da concentração destes defeitos com a temperatura para passos de

elétrico foi estudada, revelando aspectos importantes sobre as correspondentes barreiras de potencial.

tratamento térmico rápido também foi estudada. Para ambos os defeitos, uma etapa de forte diminuição na concentração foi identificada a temperaturas em torno de 250 a 300°C. Por fim, a variação das taxas de emissão destes dois níveis com o campo